

北京赛微电子股份有限公司

关于全资子公司向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款的议案》，现将有关情况公告如下：

公司于2021年12月3日召开的第四届董事会第十九会议审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司少数股权的议案》，同意公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）与瑞典Silex Microsystems AB（以下简称“瑞典Silex”）少数股东签署《股份买卖协议》，赛莱克斯国际以55,739.30万瑞典克朗（以2021年11月26日汇率中间价SEK/CNY0.7027折算成人民币为39,168.01万元；最终人民币实际收购金额以实际支付时的汇率换算价格为准）收购瑞典Silex少数股东合计持有的9.73%股权，具体内容详见公司于2021年12月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2021-145）。

为满足公司发展及支付/置换部分并购款的需要，在充分协商的基础上，公司全资子公司赛莱克斯国际拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请不超过1.75亿瑞典克朗或等值人民币（以2023年12月8日汇率中间价SEK/CNY0.6851，1.75亿瑞典克朗折算成人民币为1.20亿元）的并购贷款，贷款期限不超过五年，用于支付/置换赛莱克斯国际收购瑞典Silex少数股东合计持有的9.73%股权的部分并购款，最终贷款额度和期限以赛莱克斯国际与招商银行签订的最终协议为准。

公司及公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为赛莱克斯国际申请的上述并购贷款提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以该子公司根据资金使用

计划与招商银行签订的最终协议为准，该子公司免于支付担保费用。

公司董事会授权公司及相关子公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及相关子公司承担。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2023年12月15日